

平成26年3月期（第12期） 決算説明会

平成26年5月21日
株式会社ジーダット

1.平成26年3月期 決算概要

2.平成27年3月期 計画・業績予想

平成26年3月期のポイント

売上高:13.7億円(対前年比14.7%増)
営業利益:黒字化、経常利益:1億円超

海外向け売上高が大幅に伸長(中国,韓国)

ソリューション・ビジネスの順調なテイクオフ

組織変更による固定費圧縮

平成26年 3 月期業績概要 (連結P/L)

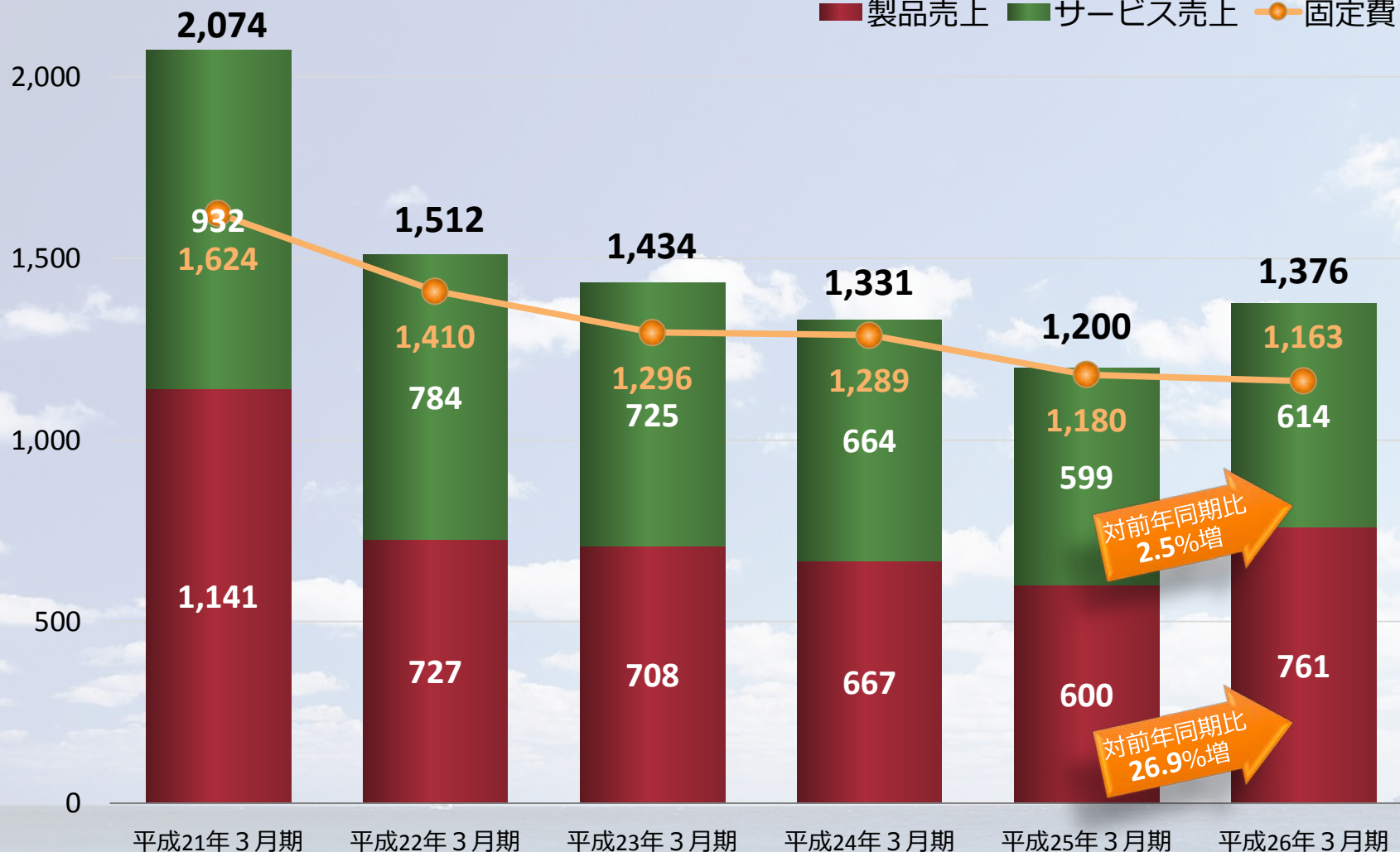
(単位：百万円)

	平成25年 3 月期		平成26年 3 月期		
	実績	売上高比	実績	売上高比	対前年同期比
売上高	1,200	100.0%	1,376	100.0%	+14.7%
売上総利益	976	81.4%	1,068	77.6%	+9.5%
販売費及び一般管理費	1,073	89.4%	989	71.9%	△7.8%
営業利益	△96	△8.1%	79	5.8%	—
経常利益	18	1.5%	128	9.3%	606.7%
当期純利益	13	1.2%	104	7.6%	650.2%

売上高・固定費の推移

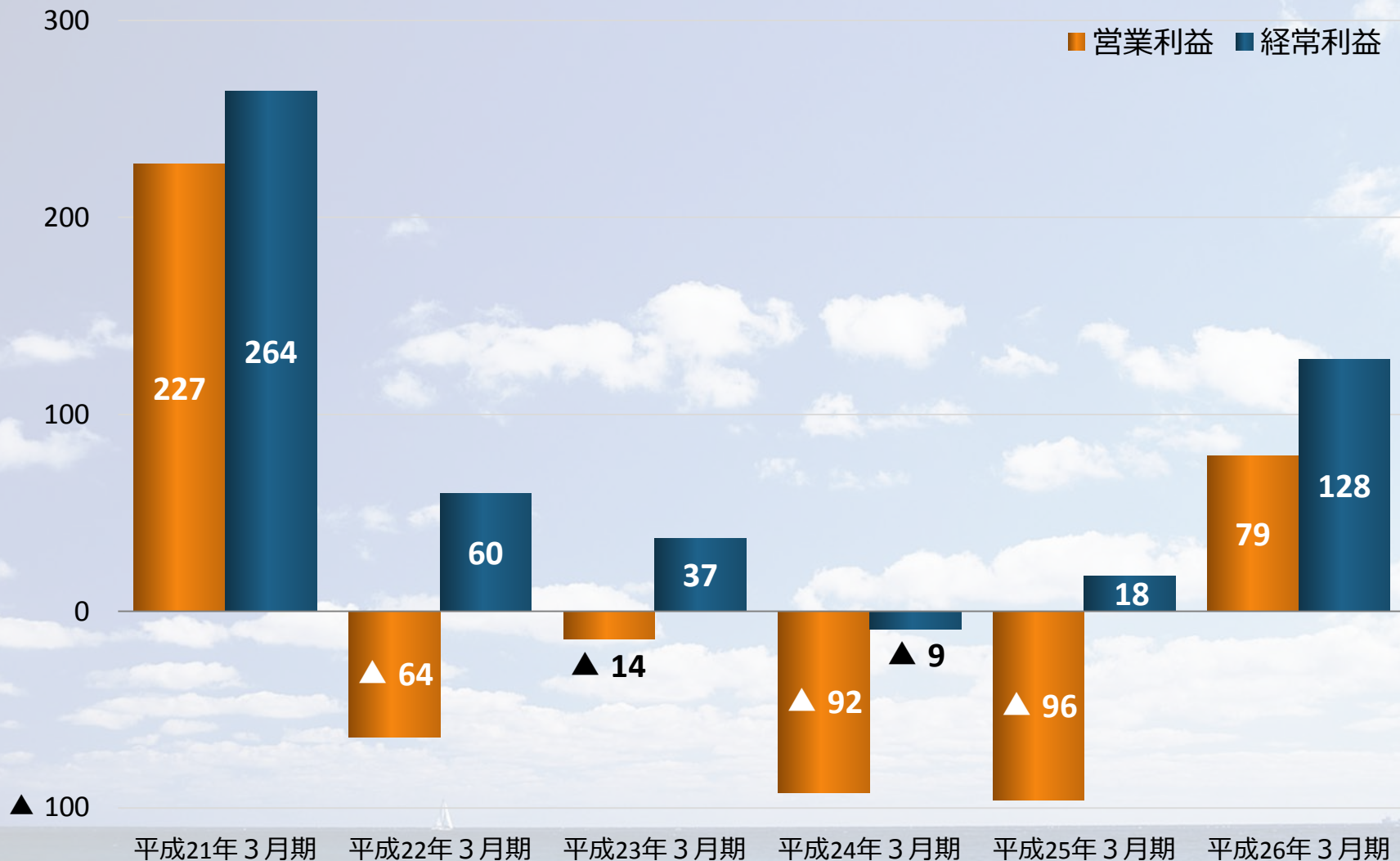
(単位：百万円)

■ 製品売上 ■ サービス売上 ● 固定費



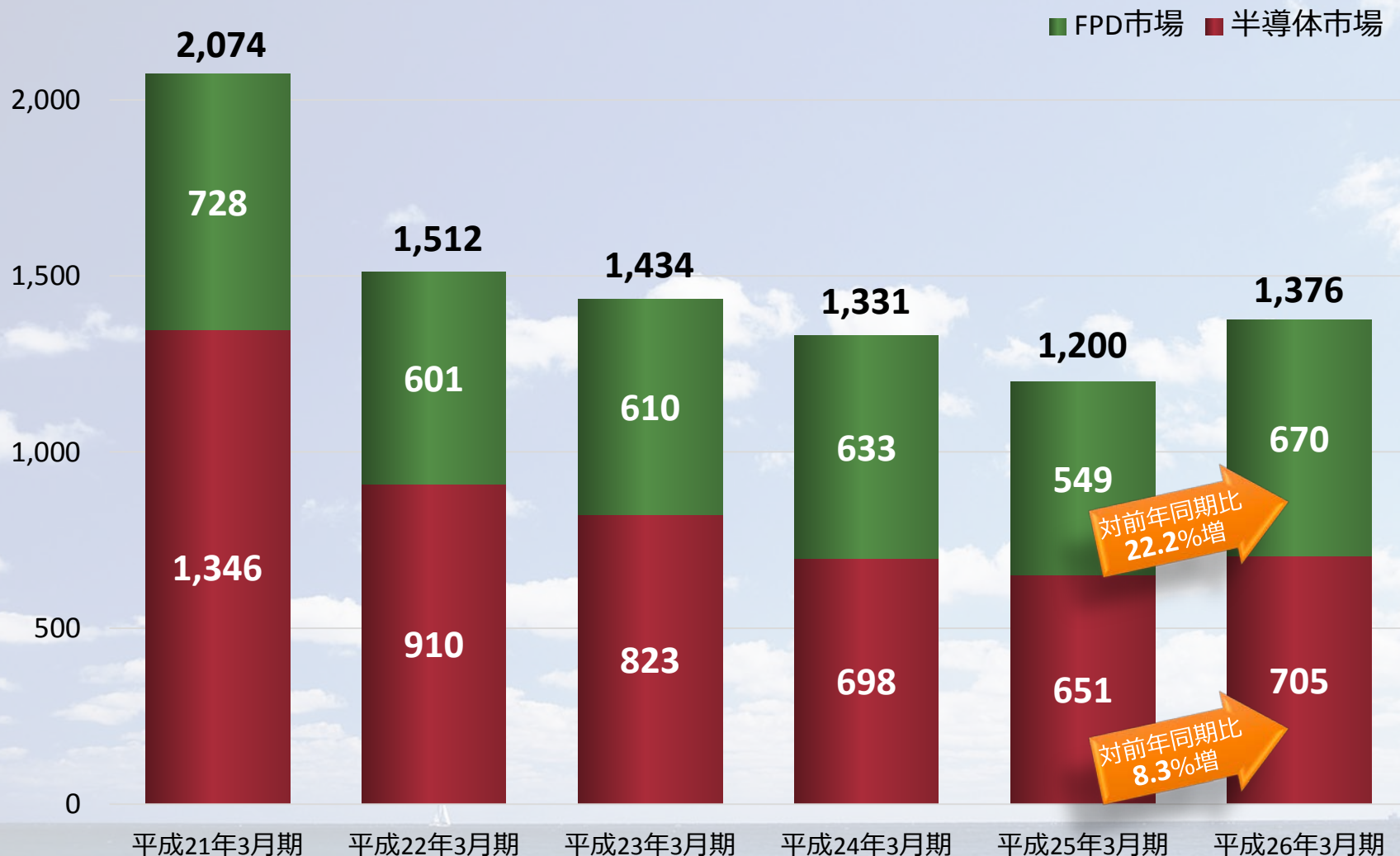
利益の推移

(単位：百万円)



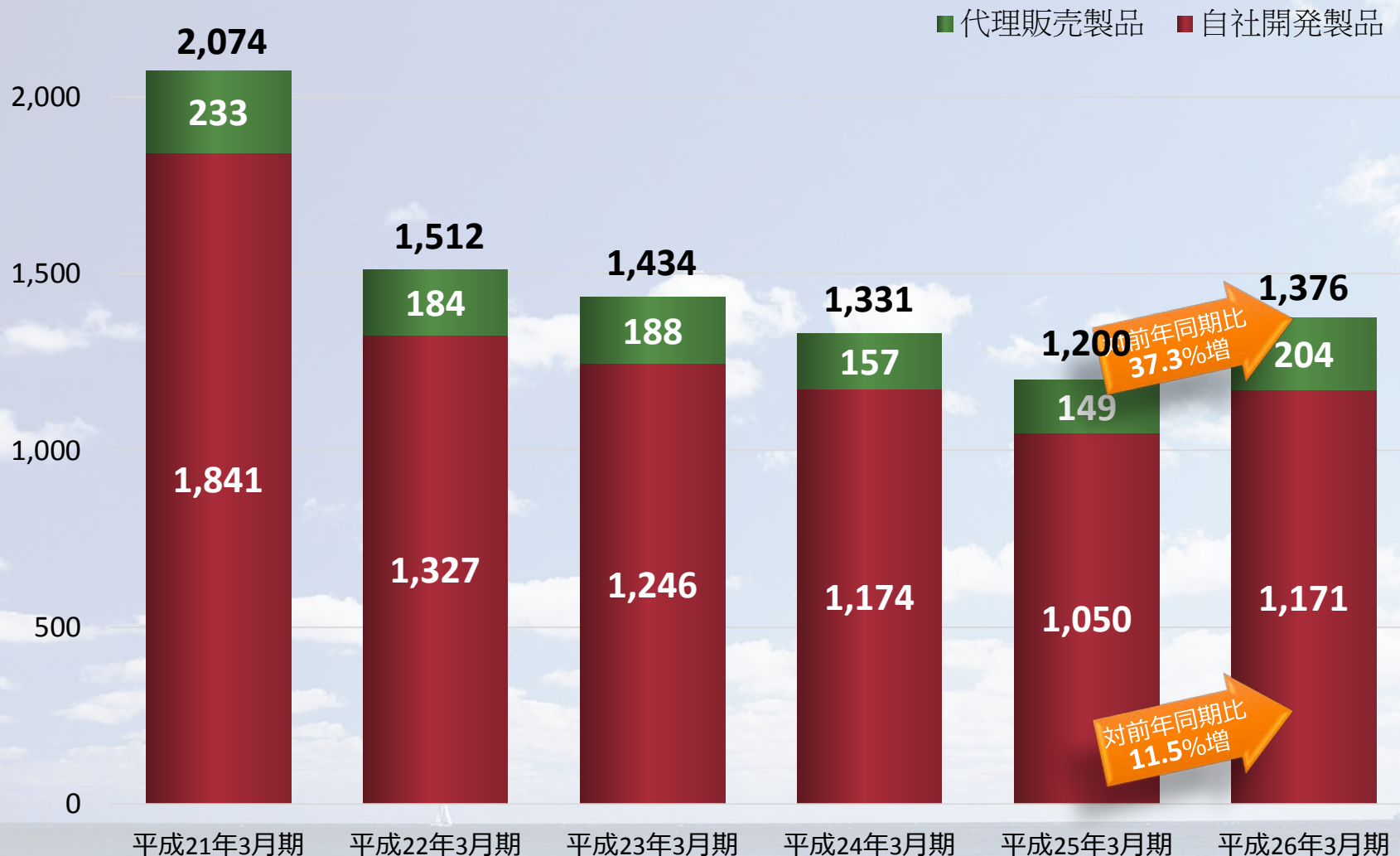
市場別売上高（半導体/FPD）

（単位：百万円）

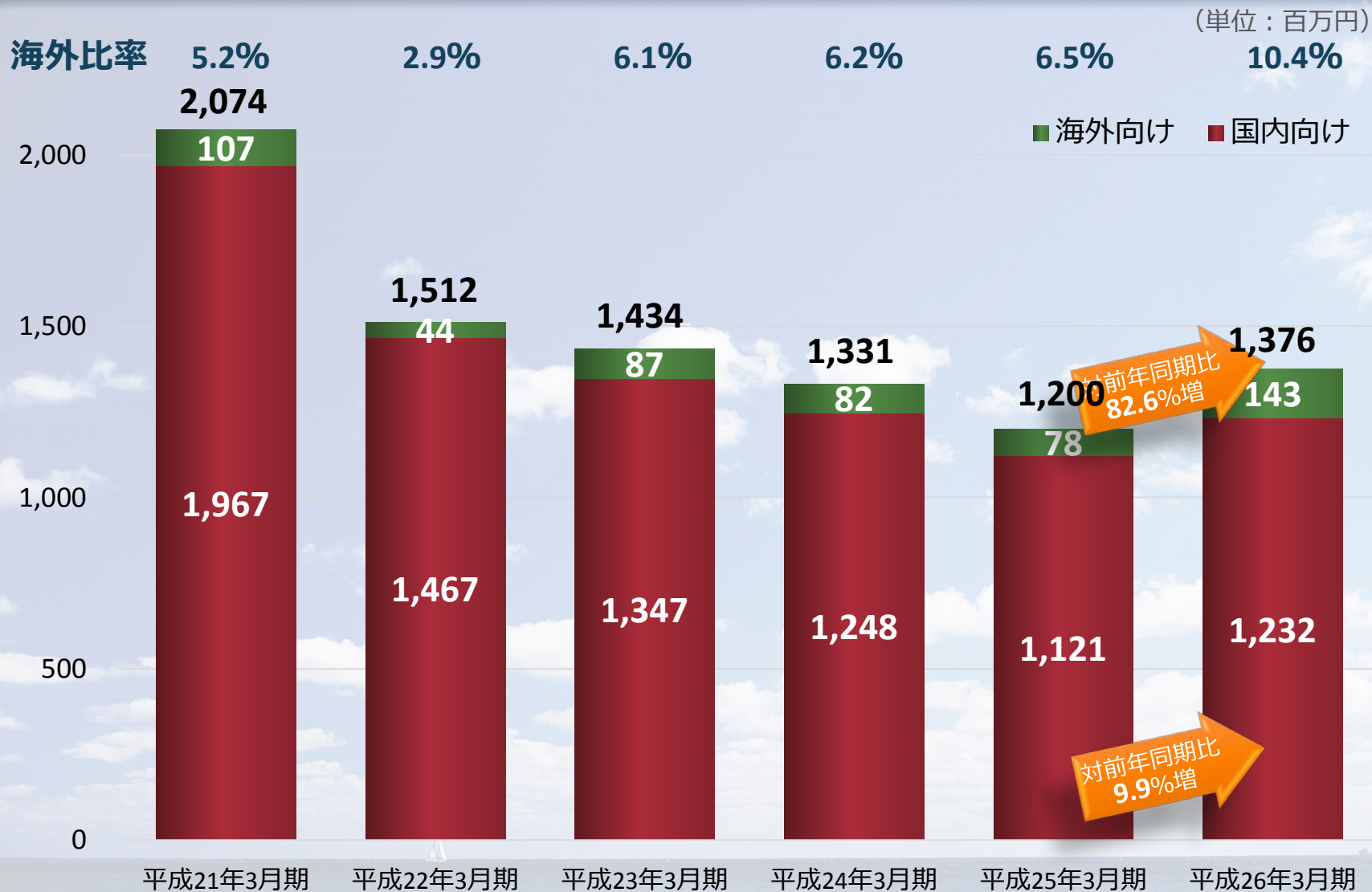


製品区分別売上高（自社開発/代理販売）

（単位：百万円）

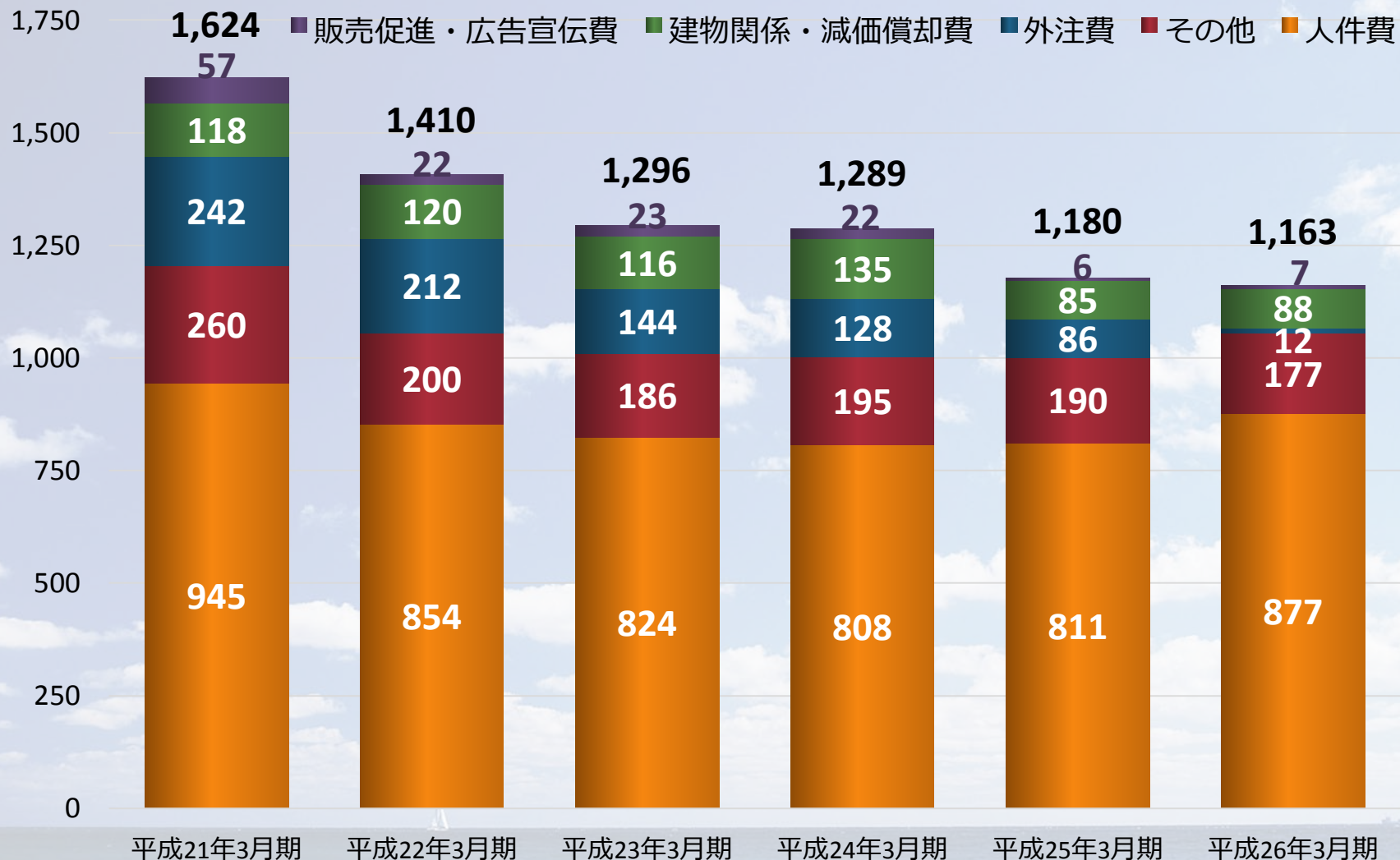


販売先別売上高 (国内/海外)



固定費内訳

(単位：百万円)



連結貸借対照表

(単位：百万円)

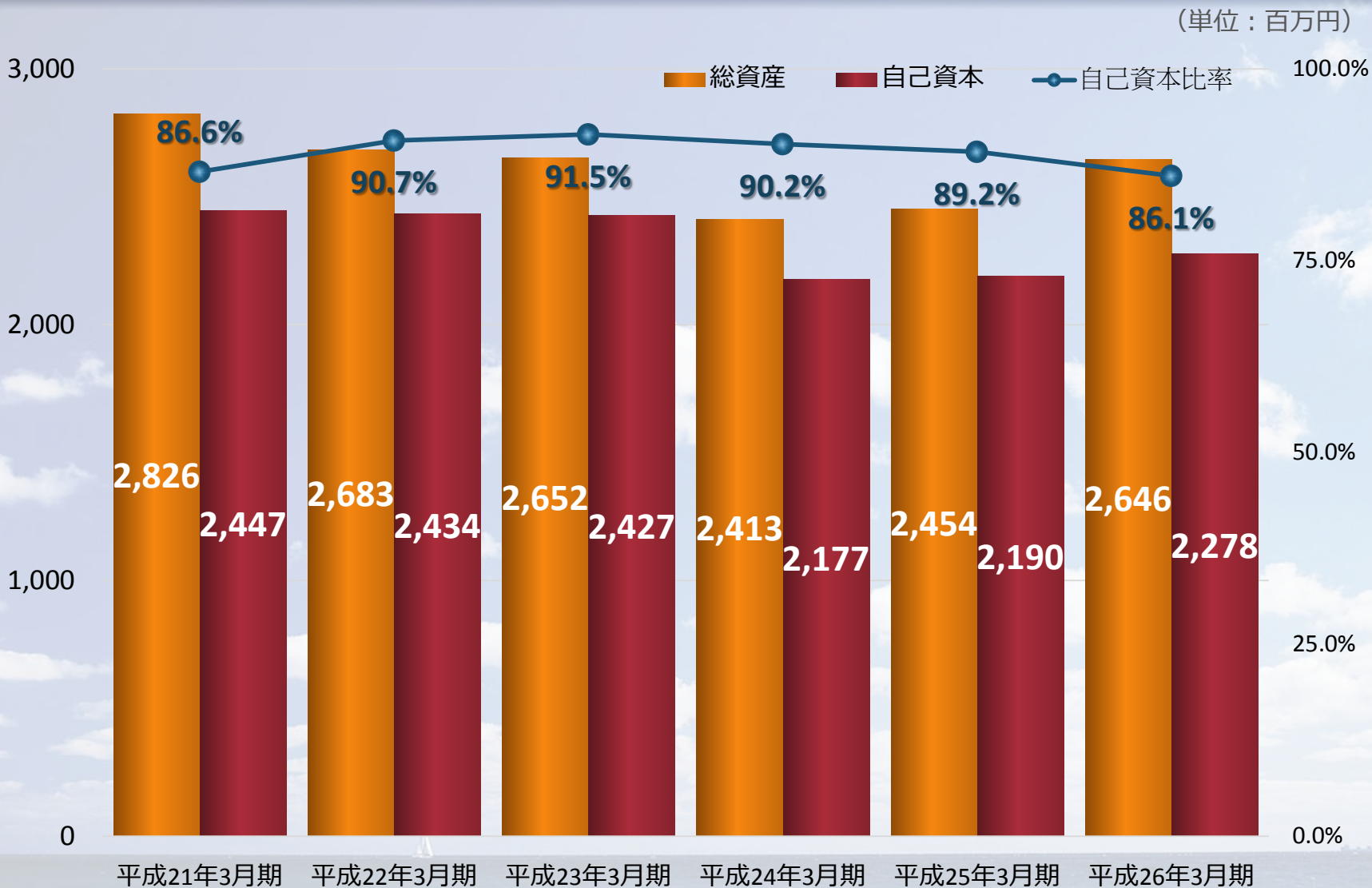
	平成25年 3月期末	平成26年 3月期末	差異		平成25年 3月期末	平成26年 3月期末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,197	2,083	△113	I 流動負債	264	320	56
1 現金及び預金	1,984	1,819	△164	1 買掛金	19	37	17
2 受取手形及び売掛金	171	124	△46	2 未払法人税等	6	18	11
3 電子記録債権	—	72	72	3 賞与引当金	56	64	8
4 有価証券	—	—	—	4 その他	181	200	19
5 たな卸資産	3	28	24	負債合計	264	320	56
6 繰延税金資産	—	—	—	(純資産の部)			
7 その他	38	38	0	I 株主資本	2,183	2,278	95
II 固定資産	256	562	305	1 資本金	760	760	—
1 有形固定資産	21	23	1	2 資本剰余金	890	890	—
2 無形固定資産	9	19	9	3 利益剰余金	565	660	95
3 投資その他の資産合計	225	520	294	4 自己株式	△32	△32	—
投資有価証券	200	500	300	II 評価・換算差額等	7	0	△7
その他	25	20	△5	為替換算調整勘定	7	0	△7
資産合計	2,454	2,646	191	II 少数株主持分	0	47	47
				純資産合計	2,190	2,326	135
				負債純資産合計	2,454	2,646	191

連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	平成25年 3月期末	平成26年 3月期末	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	126	121	△5
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△111	△340	△229
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△9	46	56
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	8	8	0
V 現金及び現金同等物の増減額	14	△164	△179
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,069	1,084	14
その他の現金及び現金同等物の増減額	—	—	—
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,084	919	△164

総資産・自己資本



- ◆ **開発子会社(JII)の吸収合併**
- ◆ **上海に販売子会社(AJM)を設立**
- ◆ **ソリューション・ビジネスの開始**
- ◆ **新規代理販売製品の販売開始**
- ◆ **DACに新製品を出展**
- ◆ **北京の開発子会社(JCS)の譲渡**

1.平成26年3月期 決算概要

2.平成27年3月期 計画・業績予想

平成27年3月期のポイント

売上高:15.8億円(対前年比14.8%増)
営業利益:1.2億円(対前年比51.5%増)

研究開発費を集中投入(解析系ツール、新製品)

海外向け販売力の強化を継続

ソリューション・ビジネスの拡張

平成27年 3 月期業績概要 (連結P/L)

(単位：百万円)

	平成26年 3 月期		平成27年 3 月期		
	実績	売上高比	予想	売上高比	対前年同期比
売上高	1,376	100.0%	1,580	100.0%	14.8%
売上総利益	1,068	77.6%	1,110	70.3%	3.9%
販売費及び 一般管理費	989	71.9%	990	62.7%	0.1%
営業利益	79	5.8%	120	7.6%	51.5%
経常利益	128	9.3%	120	7.6%	△6.6%
当期純利益	104	7.6%	112	7.1%	7.0%

半導体・FPD業界では再編・リストラを実施中



国内顧客市場の縮小傾向は継続

課
題

製品競争力のさらなる向上

海外向け販売力の強化

ソリューション・ビジネスの拡大

◆製品競争力のさらなる向上

- 主力製品の機能・性能向上を追求
- 好調分野(自動車・携帯機器関連)向けにフォーカスした解析系ツールの強化
- 最先端テクノロジー向け新製品の開発・リリース
- 新規代理販売品の品揃えを拡充

◆海外市場向け販売力の強化

- 販売子会社を強力に支援(中国)
- 各国代理店との関係の見直し・再編を計画
- DACにおける新製品の出展を継続

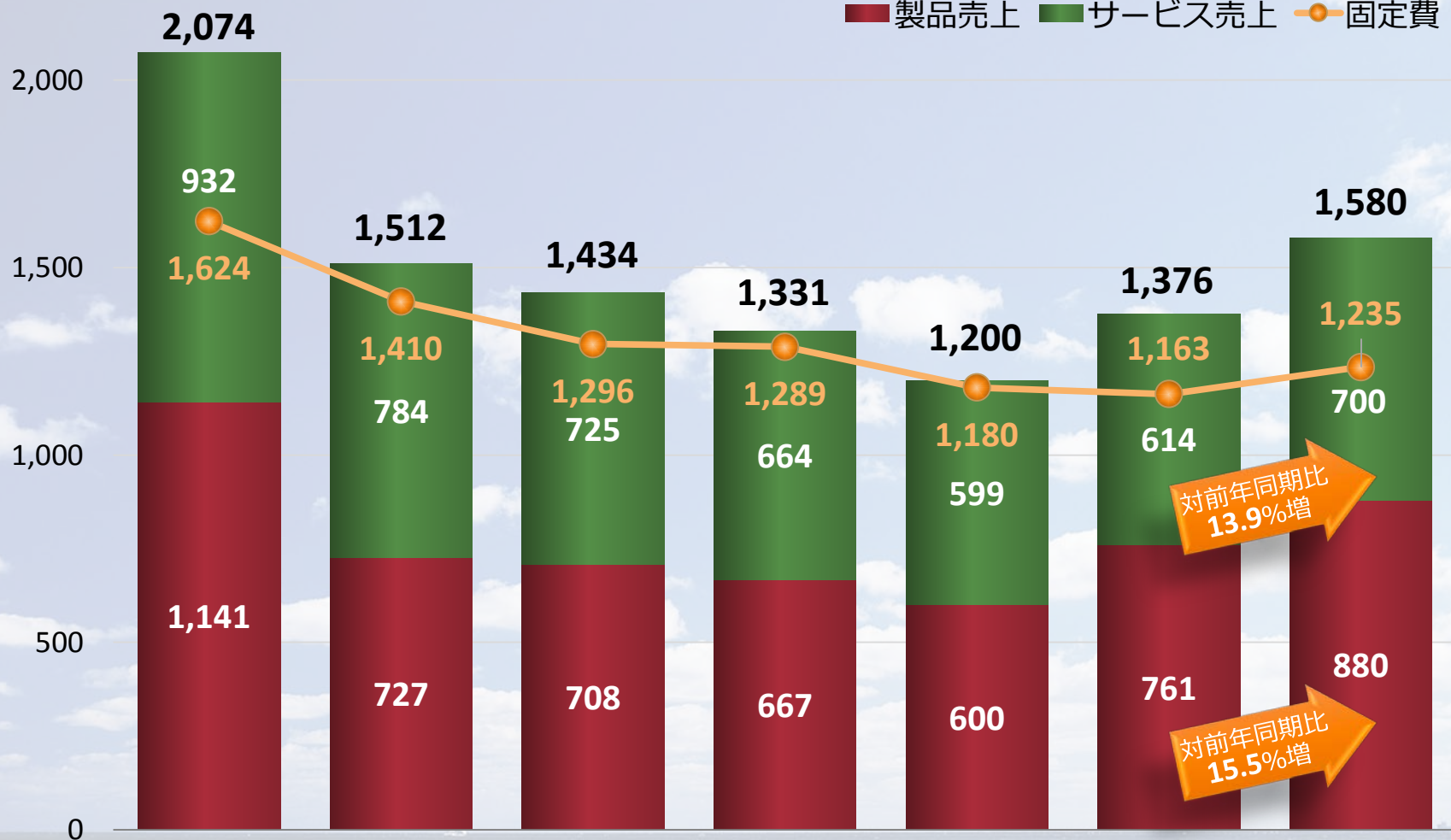
◆ソリューション・ビジネスの拡大

- **カスタムソフト受託開発(半導体・FPD)の拡大**
- **ソリューション受託開発(自動車関連)の継続**
- **EDAアウトソーシング・ビジネスの立上げ (New)**
 - **半導体・FPD設計環境の構築・保守に関する受託ビジネスを開始**
- **デザインセンター・ビジネスの立上げ準備 (New)**
 - **半導体の設計受託ビジネス立上げに向けた準備を開始**
 - **今年度下期にデザインセンターの立上げを計画**

売上高・固定費

(単位：百万円)

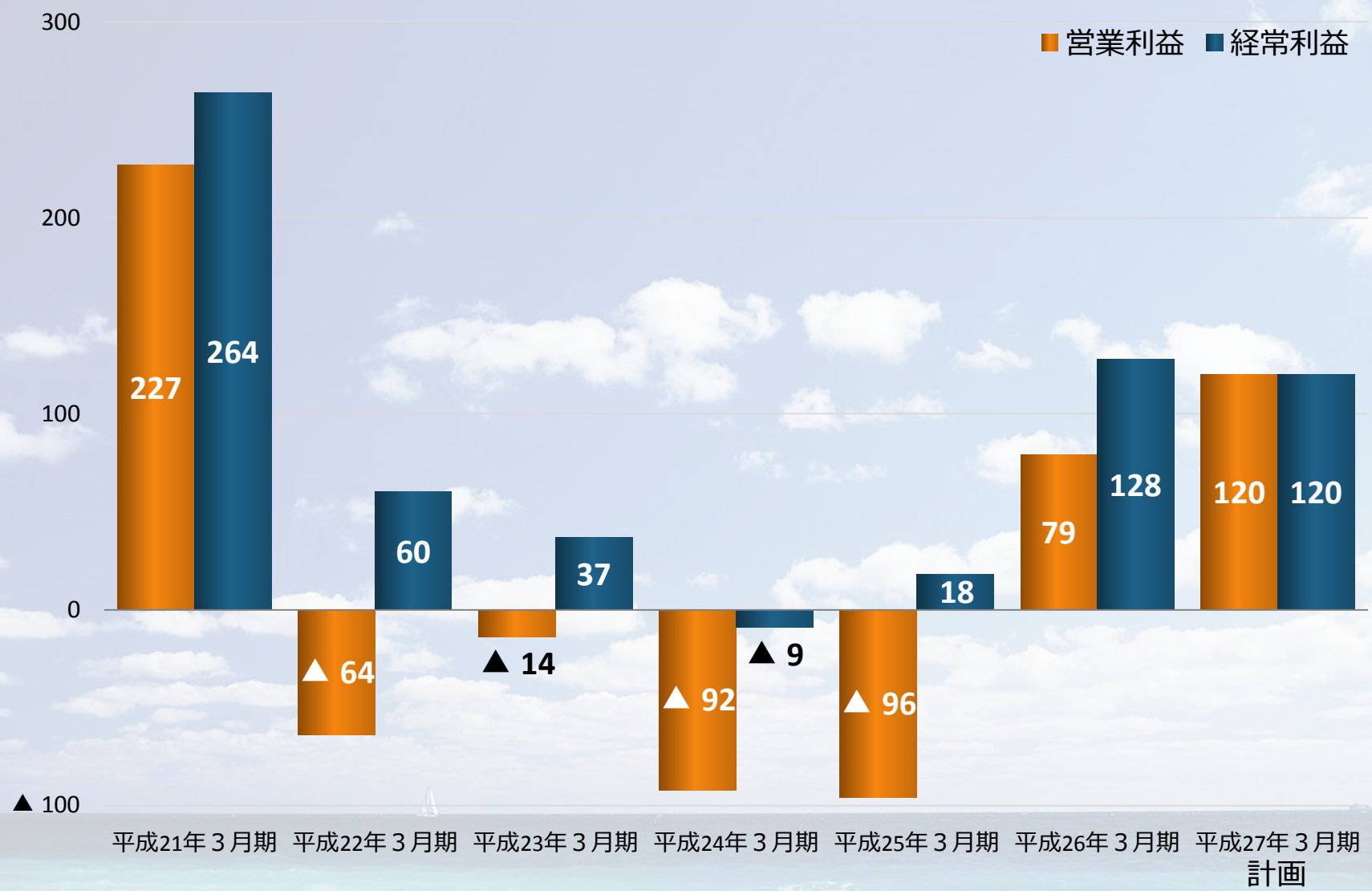
■ 製品売上 ■ サービス売上 ● 固定費



平成21年 3月期 平成22年 3月期 平成23年 3月期 平成24年 3月期 平成25年 3月期 平成26年 3月期 平成27年 3月期
計画

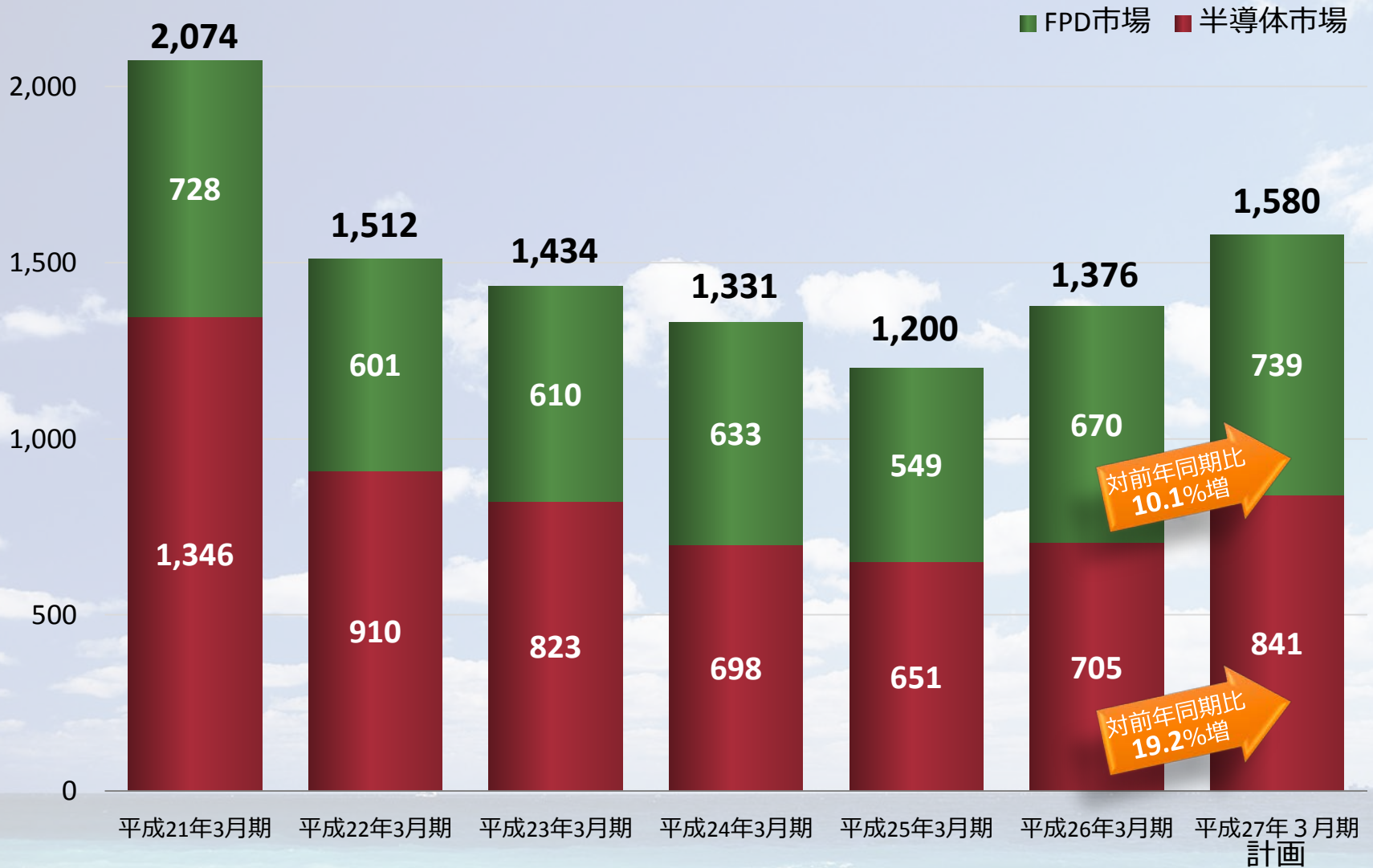
利益

(単位：百万円)

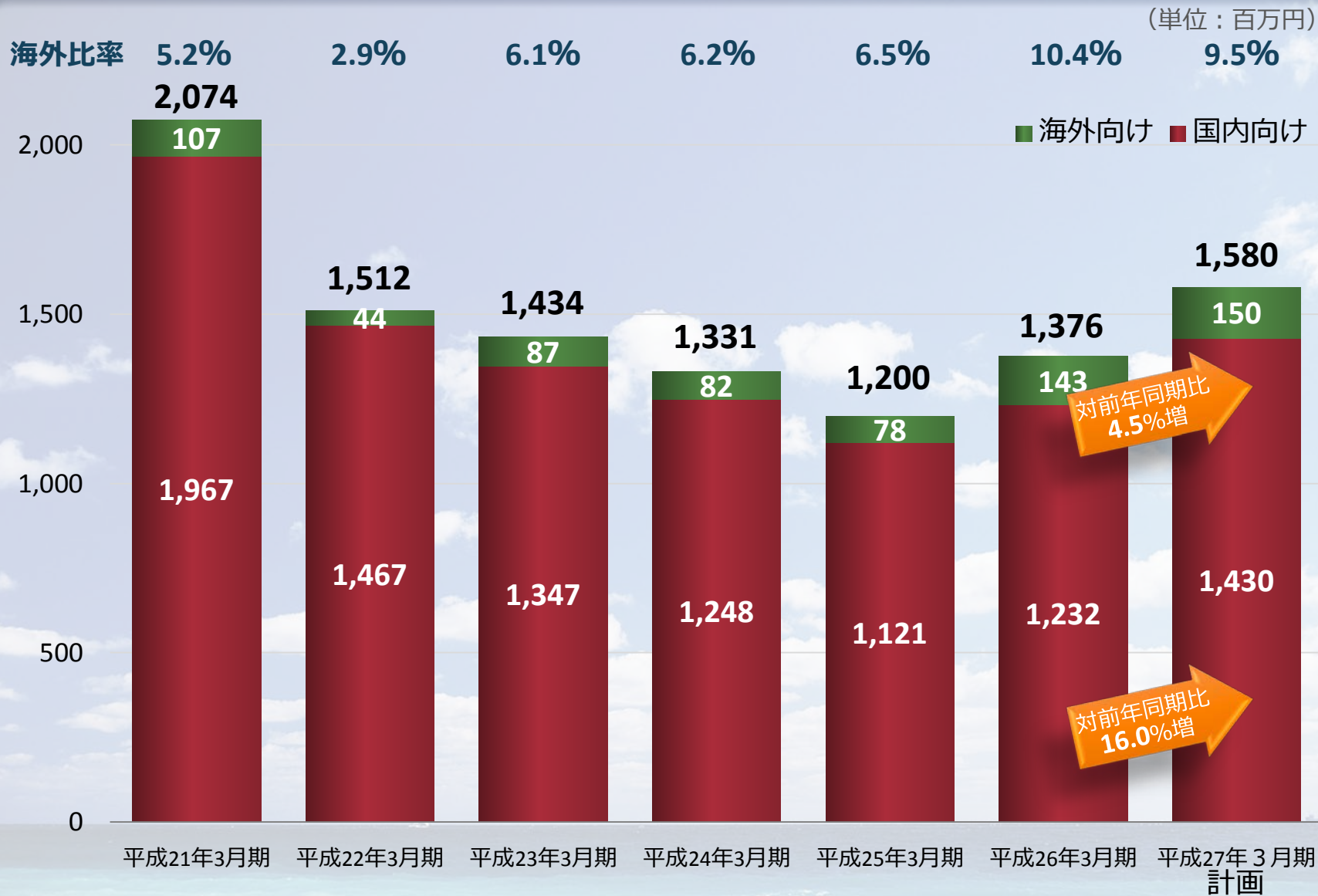


市場別売上高（半導体/FPD）

(単位：百万円)



販売先別売上高 (国内/海外)



ご清聴ありがとうございました